

主要特点

- IC控制电路与RGB三通道LED点光源共用一个电源，每个通道工作电流5mA。
- 控制电路与RGB芯片集成在一个3535封装的元器件中，构成一个完整的外控像素点。
- 内置信号整形电路，任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出，保证线路波形畸变不会累加。
- 内置上电复位和掉电复位电路。
- 每个像素点的三基色颜色可实现256级亮度显示，完成16777216种颜色的全真色彩显示。
- 端口扫描频率2KHz/s。
- 串行级联接口，能通过一根信号线完成数据的接收与解码。
- 任意两点传输距离在不超过2米时无需增加任何电路。
- 当刷新速率30帧/秒时，级联数不小于1024点。
- 数据发送速度可达800Kbps。
- 光的颜色高度一致，性价比高。

主要应用领域

- LED全彩发光字灯串，LED全彩软灯条硬灯条，LED护栏管。
- LED点光源，LED像素屏，LED异形屏，各种电子产品，电器设备跑马灯。

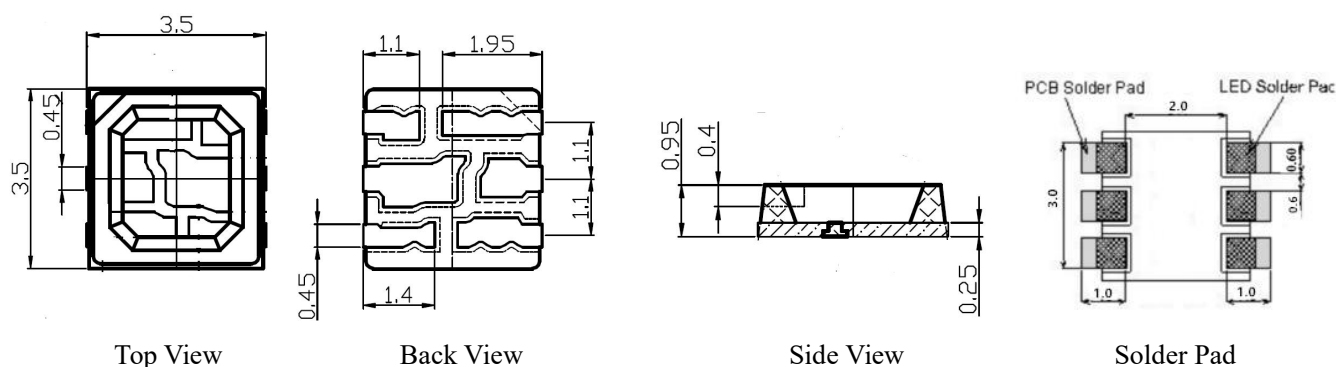
产品概述

WS2812C-MINI-6P是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源；其外型与一个3535LED灯珠相同，每个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路，还包含有高精度的内部振荡器和可编程定电流控制部分，有效保证了像素点光的颜色高度一致。

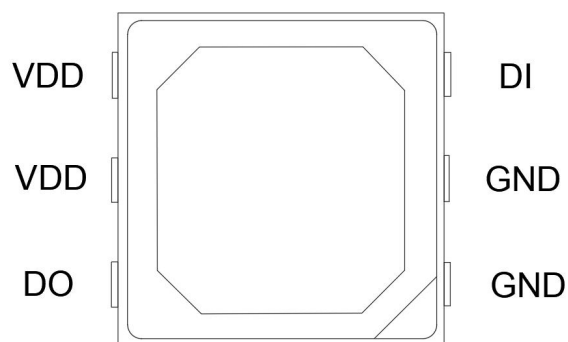
数据协议采用单线归零码的通讯方式，像素点在上电复位以后，DIN端接受从控制器传输过来的数据，首先送过来的24bit数据被第一个像素点提取后，送到像素点内部的数据锁存器，剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点，每经过一个像素点的传输，信号减少24bit；像素点采用自动整形转发技术，使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制，仅受限信号传输速度要求。

高达 **2KHz** 的端口扫描频率，在高清摄像头的捕捉下都不会出现闪烁现象，非常适合高速移动产品的使用；**280μs**以上的**RESET**时间，出现中断也不会引起误复位，可以支持更低频率、性价比更高的MCU；LED具有低电压驱动、环保节能、亮度高、散射角度大、一致性好、超低功率及超长寿命等优点。将控制电路集成于LED上面，电路变得更加简单，体积小，安装更加简便。

机械尺寸 (单位mm)



引出端排列及功能



序号	符号	管脚名	功能描述
1	VDD	电源正极	供电管脚
2	DO	数据输出	控制数据信号输出
3	GND	电源负极	信号接地和电源接地
4	DI	数据输入	控制数据信号输入

最大额定值

参数	符号	范围	单位
电源电压	V _{DD}	+3.7~+5.3	V
逻辑输入电压	V _I	-0.3V~V _{DD} +0.7	V
工作温度	T _{opt}	-40~+65	°C
储存温度	T _{stg}	-40~+85	°C

电气参数 (T_A=25°C, V_{DD}=5V, V_{SS}=0V)

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
输入电流	I _I	—	—	±1	μA	V _I =V _{DD} /V _{SS}
高电平输入	V _{IH}	0.7V _{DD}	—	V _{DD} +0.7V	V	D _{IN} , SET
低电平输入	V _{IL}	-0.3V	—	0.7V	V	D _{IN} , SET

开关特性 (T_A=25°C, V_{DD}=5V, V_{SS}=0V)

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
传输延迟时间	t _{PLZ}	—	—	300	ns	CL=15pF, DIN→DO _{UT} , RL=10KΩ
下降时间	t _{THZ}	—	—	120	μs	CL=300pF, O _{UTR} /O _{UTG} /O _{UTB}
输入电容	C _I	—	—	15	pF	—

LED 特性参数

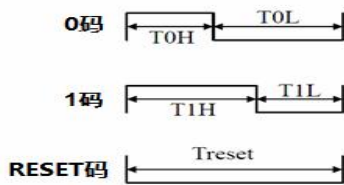
参数	符号	颜色	静态电流: ≦0.6mA				测试条件: 5V (工作电流)
			最小值	典型值	最大值	单位	
发光强度	IV	Red	150	200	250	mcd	5mA
		Green	300	390	480		
		Blue	50	70	90		
波长	λ _d	Red	620	622.5	625	nm	5mA
		Green	520	522.5	525		
		Blue	463	465	468		

数据传输时间

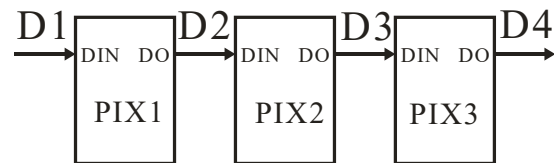
T _{0H}	0 码, 高电平时间	220ns~380ns
T _{1H}	1 码, 高电平时间	580ns~1μs
T _{0L}	0 码, 低电平时间	580ns~1μs
T _{1L}	1 码, 低电平时间	580ns~1μs
RES	帧单位, 低电平时间	280μs 以上
T _{0H} +T _{0L} 、T _{1H} +T _{1L} ≥1.25μs		

时序波形图

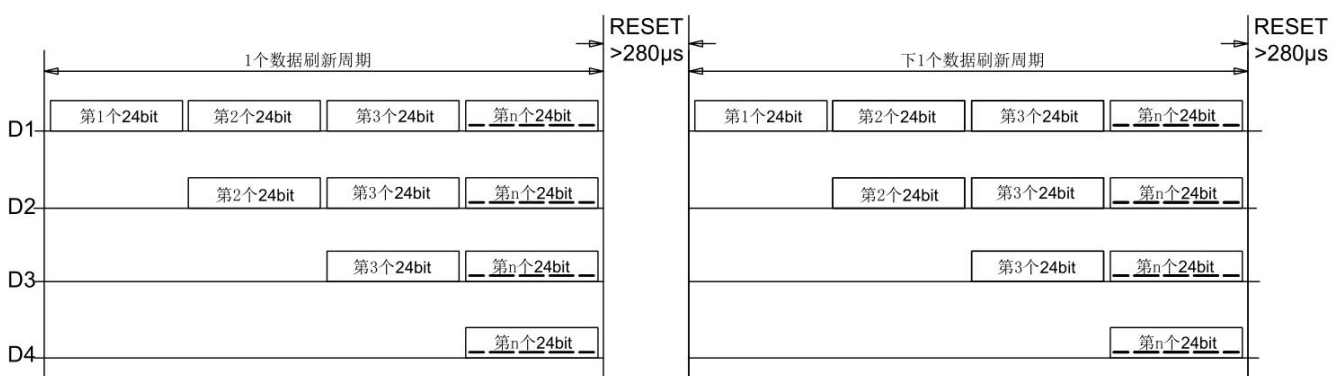
输入码型:



连接方法:



数据传输方法



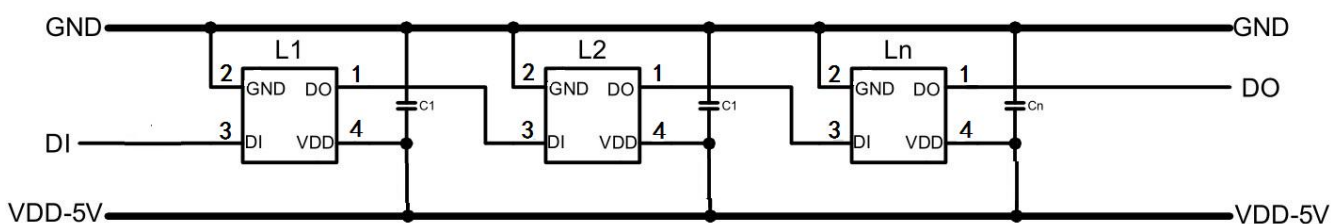
注: 其中 D1 为 MCU 端发送的数据, D2、D3、D4 为级联电路自动整形转发的数据。

24bit 数据结构

G7	G6	G5	G4	G3	G2	G1	G0	R7	R6	R5	R4	R3	R2	R1	R0	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

注: 高位先发, 按照 GRB 的顺序发送数据。

典型应用电路



其中 C1 为灯珠 VDD 脚的滤波电容, 一般取值 100NF.

表面贴装型 LED 使用注意事项

1. 描述:

通常 LED 也像其它的电子元件一样有着相同的使用方法, 为了让客户更好地使用我司的 LED 产品, 请参看下面的 LED 保护预防措施。

2. 注意事项:

2.1. 灰尘与清洁

LED 的表面是采用改性环氧胶封装的, 环氧胶对于 LED 的光学系统和抗老化性能都起到很好的保护作用。环氧胶易粘灰尘, 保持作业环境的洁净。当 LED 表面有一定限度内的尘埃, 也不会影响到发光亮度, 但我们仍应避免尘埃落到 LED 表面。打开包装袋的就优先使用, 安装过 LED 的组件应存放在干净的容器中, 在 LED 表面需要清洁时, 如果使用三氯乙烯或者丙酮等溶液会出现使 LED 表面溶解等现象, 不可使用具有溶解性的溶液清洁 LED, 可使用一此异丙基的溶液, 在使用任何清洁溶液之前都应确认是否会对 LED 有溶解作用; 请不要用超声波的方法清洁 LED, 如果产品必须使用超声波, 那么就要评估影响 LED 的一些参数, 如超声波功率, 烘烤的时间和装配的条件等, 在清洁之前必须试运行, 确认是否会影响到 LED。

2.2. 防潮包装

LED 属于湿敏元件, 将 LED 包装在铝膜的袋中是为了避免 LED 在运输和储存时吸收湿气, 在包装袋中放有干燥剂, 以吸收湿气。如果 LED 吸收了水气, 那么在 LED 过回流焊时, 水气就会蒸发而膨胀, 有可能使胶体与支架脱离以及损害 LED 的光学系统。由于这个原因, 防湿包装是为了使包装袋内避免有湿气, 但通常保护时间仅能维持 1~2 个月。此款产品防潮等级 (MSL) 为: **5a**。SMT 时请参照 IPC/JEDECJ-STD-020 规定的材料防潮等级 (MSL) 定义进行 MSL 管控。

防潮等级	包装拆封后车间寿命	
	时间	条件
LEVEL1	无限制	≤30°C/85%RH
LEVEL2	1 年	≤30°C/60%RH
LEVEL2a	4 周	≤30°C/60%RH
LEVEL3	168 小时	≤30°C/60%RH
LEVEL4	72 小时	≤30°C/60%RH
LEVEL5	48 小时	≤30°C/60%RH
LEVEL5a	24 小时	≤30°C/60%RH
LEVEL6	取出即用	≤30°C/60%RH

2.3 SMT 贴片说明:

2.3.1 建议 LED 在 SMT 前拆袋，整卷放入烤箱中进行除湿干燥（70~75℃烘烤≧24H）；

2.3.2 产品从烤箱中取出至高温焊接完成（包含多次回流焊、浸锡、波峰焊、加热维修等高温操作/作业），时间段控制在 24 内（在 T<30℃，RH<60%条件下）；

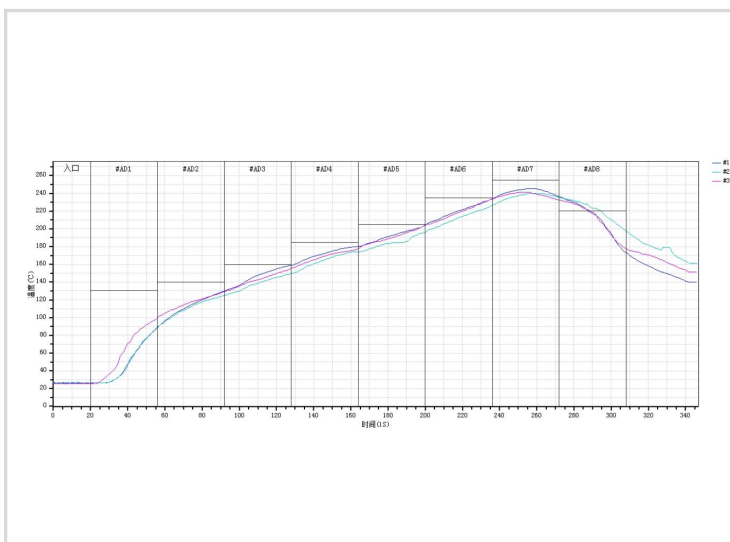
2.3.3 LED 贴片在印刷锡膏后的 PCBA 上，应尽快完成 SMT，建议不超过 1H；

2.3.4 生产剩余、机台抛料、维修用料等散料 LED，若长时间暴露在空气中，不可直接使用，建议进行除湿干燥后再被使用。整卷烘烤：70~75℃* ≧24H 或 散料烘烤：120℃*4H。

3. 焊接

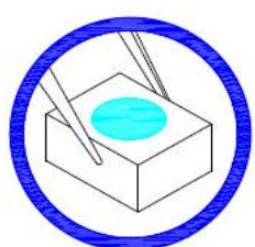
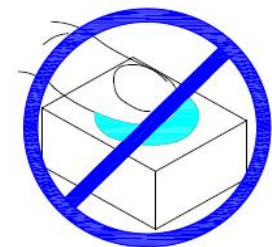
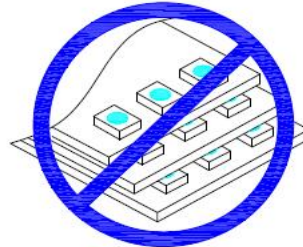

表贴应用 LED 应符合 JEDECJ-STD-020C 标准，作为一般指导原则，建议遵循所用焊锡膏制造商推荐的焊接温度曲线，或使用我司如下推荐的焊接温度曲线。

温度曲线描述	范围
30℃~150℃预热斜率	1~4 °C/s
30℃~150℃预热时间	60~120 s
150℃~200℃恒温斜率	0~3 °C/s
150℃~200℃恒温时间	60~120 s
液相温度	217℃
峰值温度	245℃
回流焊斜率	0~3 °C/s
回流焊时间	45~90 s
降温速率	-4~0 °C/s
室温至峰值温度停留时间	<6 min



注：1. 以上所有温度是指在封装本体上表面测的温度

4. 产品配装过程注意事项

1. 通过使用适当的工具从材料侧面夹取	2. 不可直接用手或尖锐金属压胶体表面，它可能会损坏内部电路	3. 不可将模组材料堆积在一起，它可能会损坏内部电路	4. 不可用在 PH<7 的酸性场所
			

文件更改记录

版本号	状态	修改内容概要	修订日期	修订人	批准人
V1.0	N	新建	20220324	余行辉	张鑫